

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 技術詞彙

本詞彙表載有本文件所採用若干有關本集團及我們業務的術語的釋義。該等詞彙及其釋義未必與標準業界涵義或用法相同。

「3G」	指	第三代移動通訊技術
「4G」	指	第四代移動通訊技術
「變焦」	指	自動調焦，部分光學系統的功能，可獲得物件的準確焦距而毋須人手調焦
「攝像頭模組」	指	以CSP、COB、COF及FC等多種封裝技術將鏡頭組件以及傳感器或印刷電路板或柔性印刷電路板等其他部件裝配而成的光電組件。其功能為攝取影像，然後傳送或儲存在相機的磁帶或記憶卡，以待日後以電子設備重播或列印
「CIF」	指	通用媒介格式，一種用於規範橫縱分辨率的格式，一般指分辨率為8萬像素的攝像頭模組
「無塵室」	指	一般用於製造或科研的環境，灰塵、空氣中的微生物、大氣懸浮粒子及化學煙霧等環境污染物水平低
「十級無塵室」	指	允許每立方米約3,500個大小為0.5微米及較大直徑微粒的無塵室
「千級無塵室」	指	允許每立方米約35,000個大小為0.5微米及較大直徑微粒的無塵室
「閉環控制」	指	又稱反饋控制系統，一種控制系統，原理為以開環系統作為其正向通路，同時在輸出與輸入之間設有一個或多個反饋通路
「COB」	指	基板晶片，一種將微晶片或模具直接鑲嵌在最終電路板並且連接電路的技術
「COF」	指	柔性電路芯片，主要用於LCD技術，將LCD的驅動晶片直接安裝於柔性電路，作為連接液晶顯示屏的接觸點

## 技術詞彙

「CSP」	指	晶片規格封裝，為半導體封裝規格，封裝大小不超過半導體模具的1.2倍
「模具」	指	於進行封裝前自一塊晶圓切割的獨立晶片
「FC」	指	覆晶技術，亦稱為倒晶封裝，是連接半導體儀器的一種方法
「定焦」	指	定焦，為製造時設定的焦點，並維持固定
「柔性印刷電路板」	指	柔性印刷電路板，以軟性基材（不論有否柔性面層）製成的印刷電路
「紅外線濾鏡」	指	紅外線濾鏡
「ISO」	指	國際標準化組織，總部設於瑞士日內瓦的非政府組織，評估商業組織質量系統
「LCD」	指	液晶顯示器
「百萬」	指	一個計量制度的單位，指一百萬 (10 <sup>6</sup> 或1,000,000)
「ODM」	指	原設計製造，指製造商設計及製造由客戶指定的產品，其後以客戶的品牌或並非以任何特定品牌銷售
「OEM」	指	原設備製造，為其他方品牌或轉售而製造貨品或設備的業務
「OIS」	指	光學防抖，靜物相機或攝像機所採用通過調節抵達感應器的光程來穩定拍攝畫面的原理
「OTP」	指	一次編程，一種電子程式上的唯讀記憶體
「個人電腦」	指	個人電腦
「印刷電路板」	指	印刷電路板，是絕緣材料平板或基板，其上有導體形成既定的佈局，加上電子元件焊接後形成集成電路
「印製電路板封裝」	指	印製電路板封裝

---

## 技術詞彙

---

「像素」	指	圖像元素，電腦顯示屏或電腦影像可編程的顏色基本單位
「SMT」	指	表面貼裝技術，將電子零件直接貼裝於印刷電路板的表面，可提高電路板容量、有助縮小產品體積及先進自動化生產
「USB」	指	通用串行總線，一種於一九九零年代中期發展成的行業標準，界定電腦與電子設備之間的連接、通訊及電力供應總線所使用的電纜、連接器和通訊協定
「UV」	指	電磁輻射較可視光線短波，但較X光為長，介乎400nm至10nm，相應光子能量為3 eV至124 eV
「VCM」	指	音圈馬達
「VGA」	指	分辨率為640 x 480像素的圖像，一般指分辨率為30萬像素的攝像頭模組